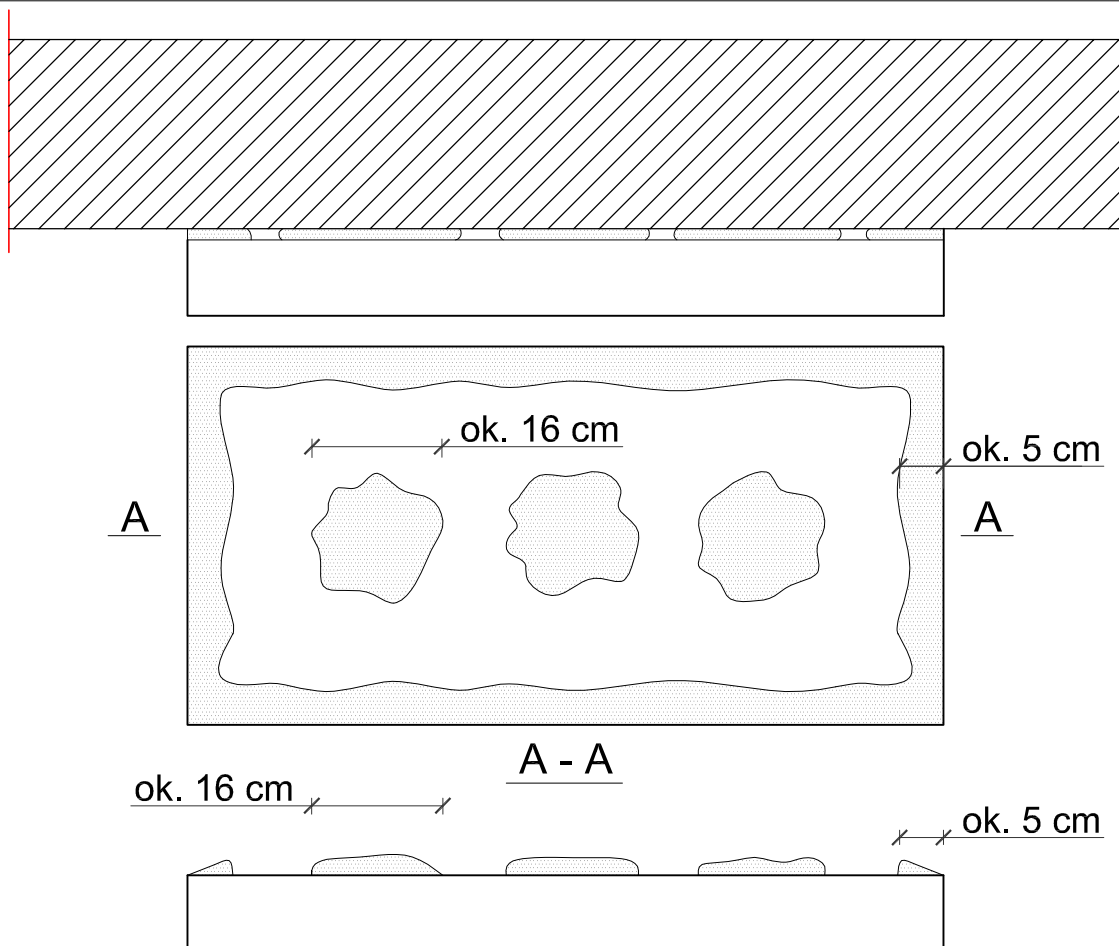


# Sposób klejenia płyt izolacji termicznej.



$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% \geq 40 \%$$

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegająca do ściany

Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej.

Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody obwodowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni.

Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całościowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY	
BUDYNKÓW PO BYŁEJ KOMENDZIE POLICJI W RACIBORZU	
	SKALA 1:10
Detal ocieplenia – detal klejenia płyt	
DANE <b>Miasto Racibórz</b>	BRANŻA: ARCHITEKTURA
INWESTORA: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6	NR RYSUNKU: <b>ADW4</b>
ADRES BUDOWY: <b>Racibórz, pl. Wolności 8-9</b>	październik 2016
PROJEKTOWAŁ: <b>mgr inż. arch. Maciej Pindur</b> 149/02 i 646/86	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: <b>mgr inż. arch. Piotr Gawliczek</b> 356/78	PODPIS:
Pracownia Projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej PINDUROWIE 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 <b>www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl</b>	

